

北京君正集成电路股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期及变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》和《关于募集资金投资项目变更的议案》，公司将对部分募集资金投资项目进行延期及变更。本次募集资金投资项目延期事项无需股东大会审议，募集资金投资项目变更事项需要股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年度发行股份购买资产募集配套资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年度发行股份购买资产募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金发行人民币普通股（A 股）18,181,818 股，发行价格为人民币 82.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,985.00 元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司实际收到募集资金人民币 1,499,999,985.00 元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会出具的《关于同意北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3097 号）核准，公司 2021 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,592,518 股，发行价格为每股人民币 103.77 元。截至 2021 年 10 月 29 日，公司募集资金总额为人民币 1,306,725,592.86 元，扣除证券承销费及保荐费用（含税）后，实际收到募集资金 1,282,076,091.37 元。募集资金总额扣除全部不含税发行费用 26,039,208.28 元后的净额为 1,280,686,384.58 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“XYZH/2021BJAB11063”号《北京君正集成电路股份有限公司 2021 年 10 月 29 日验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至报告期末，公司及子公司已与保荐机构、独立财务顾问机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议的履行不存在问题。

（三）募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计使用 2020 年度发行股份购买资产募集配套资金投入募投项目的金额为 128,867.58 万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 2,361.97 万元，募集资金账户余额合计为 23,494.41 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投入募投项目的金额为 55,790.35 万元，累计支付相关发行费用为 280.19 万元（不含证券承销费及保荐费用），累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 5,493.02 万元，募集资金账户余额合计为 77,630.06 万元。

各募集资金投资项目具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至期末累计募集资金投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
支付公司重大资产重组部分现金对价	否	115,949	115,949	115,949	100%	不适用
面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目	否	17,900	17,900	4,350.10	24.30%	2029 年 01 月 01 日
面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目	否	16,151	16,151	8,568.48	53.05%	2025 年 06 月 30 日
嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目	否	21,155.3	21,155.3	1,793.90	8.48%	2027 年 09 月 01 日
智能视频系列芯片的研发与产业化项目	否	36,239.16	36,239.16	9,560.67	26.38%	2027 年 09 月 01 日
车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目	是	17,542.44	6,587.39	6,576.90	99.84%	已变更
车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目	否	23,735.66	23,735.66	1,671.06	7.04%	2027 年 09 月 01 日
补充流动资金	否	29,254.83	29,254.83	29,355.36	100.34%	不适用
合肥君正研发中心项目	否	0	11,332.64	6,832.46	60.29%	2026 年 05 月 19 日

注：“车载LED 照明系列芯片的研发与产业化项目”已变更为“合肥君正研发中心项目”。

二、本次募集资金投资项目延期的有关情况

本次需要进行延期的募集资金投资项目为“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”。

（一）项目基本情况

本项目主要进行新一代高速存储器芯片技术及整体解决方案的研发，由公司下属子公司北京矽成半导体有限公司组织实施，计划募集资金投资金额为 16,151.00 万元。本项目建设期为 5 年，计划完成时间为 2025 年 6 月 30 日。

截至2025年3月31日，“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”累计募集资金投入金额为8,568.48万元。

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

车载存储芯片研发项目涉及产品立项、产品定义、设计开发、循环验证等各个环节，同时产业化过程涉及客户的评估、验证和方案设计、车规质量审计、车厂测试等环节，由于车规市场对可靠性、稳定性和安全性的要求比较高，整个过程往往需要较长的时间。

2020年“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”启动以来，全球政治环境、经济形势、市场环境等情况发生较大变化，使得一些研发项目的实施和落地未能如期完成。公司车载存储芯片的研发、验证及推广等工作进度均受到不同程度的影响。同时，2020年至今，汽车市场也经历了较多的需求波动，自2022年下半年开始，汽车、工业等行业市场景气度持续下降，影响了汽车市场的发展，从而影响了车规市场的产品导入进度。

同时，近几年来，随着汽车智能化的不断发展，汽车市场对存储芯片的数据传输速率、带宽和功耗等性能指标要求不断提高，对存储芯片容量的需求也在不断发展，大容量的存储产品需求不断加大，从而车规存储芯片的工艺制程也需要不断更新迭代。由于车规市场对芯片产品要求的特殊性，工艺制程的更新迭代所需时间通常较长。

“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”设立以来，公司对面向智能汽车领域的高速存储芯片进行了产品定义、设计开发、投片与验证等工作。截至目前，不同类型高速存储芯片中，部分产品已完成样品生产，部分产品研发中，部分产品已处于验证及量产阶段。随着汽车智能化的不断升级，汽车智能驾驶相关技术不断发展，车规市场对存储芯片的需求也在不断增长。公司全资子公司北京矽成在存储器领域耕耘多年，掌握了车规存储芯片的多种相关核心技术，形成了一套完整的技术体系和工程保障体系，能够面向汽车领域提供高品质、高可靠性的各类存储器产品，公司“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”市场可行性和技术可行性均未发生改变。在汽车智能化不断发展的情况下，未来车载存储芯片的市场空间将持续增长，从而给公司存储芯片产品带来更大的成长空间和较好的预期效益。

公司在募投项目实施过程中，需要根据市场发展态势不断调整技术研发和产品规划的进度，以确保募投项目投资的安全稳健。根据车规市场对存储芯片工艺制程的需求趋势，公司启动了基于更先进工艺制程的产品研发。目前公司部分新工艺的存储产品预计可于2025年开始陆续向客户提供样品，公司将持续进行更多产品工艺制程的升级迭代。

鉴于项目实施内容和可行性均未发生改变，考虑到车载存储芯片在设计开发、市场推广、客户产品导入等方面往往需要较长时间，以及项目实施过程中客观因素对实施进度可能造成的影响，公司拟对“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”进行延期，将原计划完成时间由2025年6月30日调整为2030年6月30日。

三、本次募集资金投资项目变更的有关情况

（一）项目基本情况

根据公司总体规划，公司拟将“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”。

“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”由公司下属子公司合肥君正有限公司组织实施，主要用于面向车载摄像头的ISP芯片的研发及产业化，计划使用募集资金为23,735.66万元，主要用于设备购置费、流片试制费、IT系统建设费等。根据募集资金使用计划，项目建设期为72个月，原预计达到可使用状态的日期为2027年9月。截至2025年3月31日，“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金 承诺投资 总额	募集资金 累计投入 金额	募集资金 结余金额	现金管理 收益及利息 扣除银行 手续费 净额	剩余募集 资金合计	募集资金 使用进度
车载ISP系列 芯片的研发 与产业化项 目	23,735.66	1,671.06	22,064.60	1,495.68	23,560.28	7.04%

（二）本次募集资金投资项目变更的原因及具体内容

公司为集成电路设计企业，在核心技术领域一直坚持自主创新的研发策略，经过多年的研发投入，公司在嵌入式CPU技术、视频编解码技术、影像信号处理技术、神经网络处理器技术、AI算法技术、高性能存储器技术、模拟技术、互联技术、车规级芯片设计技术等领域形成了多项核心技术，且技术领先、自主可控。公司自主创新的核心技术为公司的不断发展奠定了坚实的基础，使公司的产品在性能、功耗、性价比等各方面保持了良好的市场竞争力。公司于2020年收购北京矽成后，业务上形成了“计算+存储+模拟”三大类产品格局，并成功由消费电子市场切入汽车电子等行业市场。

“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”实施以来，公司进行了相关车规体系建设工作，车规ISP芯片关键性技术的评估和预研，以及部分核心IP的研发，目前核心IP研发和产品定义的部分工作已完成。由于公司智能视频业务的ISP技术主要面向消费类安防监控市场，与车规ISP芯片在性能、规格等方面的要求有较大差异，研发与生产流程也有所不同，因此，合肥君正需要较长时间进行车规芯片相关核心IP的技术研发、规格定义与产品设计。鉴于车规芯片从研发到产业化所需时间通常较长，预计车规ISP芯片完成设计和产业化仍需一定时间。

近年来，随着人工智能技术的不断发展，AI芯片的算力性能不断提升，面向各类应用的AI大模型也不断涌现并快速迭代与完善，基于对运行效率和数据安全性等方面的需求，在相关AI技术不断发展完善的情况下，各类智能硬件产品的数据处理模式上，有望从云端运行AI大模型、端侧接入云端模型，发展到端侧也将运行一定规模的AI模型，从而促进了对边缘算力的需求，推动着存储技术的不断发展和包括对3D DRAM在内的新型存储芯片的需求。当前AI模型和高性能计算对DRAM的带宽需求正以每年倍数级的速度增长，传统DRAM已无法满足此等速度要求，而3D DRAM通过垂直堆叠、垂直互联等技术可大幅提升DRAM的存储密度和数据带宽，从而可以有效满足AI芯片与高性能计算芯片对DRAM高带宽、大容量的需求。

公司下属全资子公司ISSI经过长期技术积累，掌握了包括DRAM、SRAM、FLASH在内的各类存储器芯片的设计技术，并形成了多项自主知识产权专利。在生产工艺方面，ISSI具有多年同各类晶圆厂商深度合作的经验，凭借其在车用存储芯片设计中的扎实基础，可在成本、功耗、性能、品控上取得更适合特定应用的有效

优化和平衡。为及时抓住AI快速发展给DRAM领域带来的巨大机会，更好地提高募集资金使用效率，并与公司正在布局的AI SoC芯片业务形成协同效应，公司拟将“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”，在已有DRAM产品基础上与产业链上下游密切合作，突破关键技术，为客户提供符合市场需求的高可靠性3D DRAM产品。本次变更所涉及的募集资金结余金额22,064.60万元占公司2021年度向特定对象发行股票募集资金总额的16.89%，募集资金结余金额加现金管理收益及利息扣除银行手续费净额合计为23,560.28万元。

“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”将由芯成半导体（上海）有限公司（以下简称“上海芯成”）组织实施，公司将用“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”的募集资金结余金额加现金管理收益及利息扣除银行手续费的净额23,560.28元投入“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”。公司将通过全资子公司北京矽成对上海芯成进行增资，并设立新的募集资金专用账户，募集资金将存放于新设立的募集资金专户中，并严格履行必要的资金使用审批及信息披露程序。公司将用自有资金继续进行ISP相关技术的研发。

本次变更不构成关联交易。

四、“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”的情况说明

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：3D DRAM芯片的研发与产业化项目
- 2、项目实施主体：芯成半导体（上海）有限公司
- 3、项目实施地点：中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路2777弄25号
- 4、项目建设内容：

针对AI芯片和高性能计算芯片对高带宽、大容量、低延迟DRAM的迫切需求，公司拟在已有DRAM技术与产品基础上开展3D DRAM芯片的研发和产业化，突破垂直堆叠、垂直互联、热管理等关键技术，采用先进工艺与先进封装技术为业界提供高密度、高带宽、高可靠性、低功耗的3D存储解决方案，以支持AI模型在数据中心、边缘计算、智能驾驶、智能终端等应用场景的高效运行。

项目计划总投资23,560.28万元，计划建设期为5年，自公司股东大会审议通过之日起。实施地点为中国(上海)自由贸易试验区锦绣东路2777弄25号。

（二）项目实施的可行性

1、公司在DRAM产品领域耕耘多年，拥有深厚的技术积累

公司下属子公司ISSI在DRAM领域已有三十多年的经营历史，凭借多年来对产品研发的大力投入以及对全球存储芯片市场的不断开拓，积累了大量的技术储备并形成了覆盖全球的销售网络，在国际市场具备较强的竞争力。公司在DRAM领域技术和产品等方面的积累为上海芯成的项目实施提供了良好的技术基础。

2、研发团队拥有丰富的经验和专业技能，项目实施具有良好的人才基础

公司在存储器领域拥有全球化的技术人才，研发团队遍布中国大陆、美国、韩国等多个国家和地区，公司DRAM研发团队技术经验丰富、研发能力突出，相关骨干人员拥有多年的行业经验，对包括DRAM芯片在内的存储器产品研发及客户需求有着深刻的理解。经验丰富的研发团队可为项目的顺利实施提供良好的人才基础。

3、公司具有规范的研发流程和管理制度，项目实施具有良好的管理保障

项目管理水平直接决定着项目的研发成果。经过多年的摸索和实践，公司已建立起较为成熟的产品研发流程，并严格根据ISO9001技术标准和规范开展研发活动。同时，公司还具有一整套管理规章制度，可以保证项目研发活动的顺利开展，为项目实施提供良好的管理保障。

（三）项目实施的必要性

1、3D DRAM市场潜力巨大，抢抓难得的新兴市场机遇

随着人工智能和高性能计算的爆发式增长，算力设备持续升级，AI技术在越来越多的领域得到应用，市场对高带宽、低功耗存储器的需求持续攀升。边缘计算的快速发展进一步促进了对包括3D DRAM在内的新型存储产品的巨大需求，未来几年内3D DRAM市场规模有望迎来爆发性增长。面对如此巨大的新兴存储市场，SK海力士、三星、美光等国际存储巨头均已加速布局。为及时跟进这一巨量市场的需求，公司启动了3D DRAM产品的研发，以抢抓这一难得的新兴市场机遇。

2、不断丰富公司存储芯片产品线，提高公司综合竞争力

公司存储芯片按照产品类型分为DRAM、SRAM和FLASH等品类，其中DRAM产品的销售规模在存储芯片产品线中占据较大份额。公司DRAM产品主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域开发，产品包括DDR、DDR2、LPDDR2、DDR3、

DDR4、LPDDR4等多种类型，主要应用于工业、消费、通讯和汽车等领域。

3D DRAM芯片通过三维集成、垂直互联等技术来大幅提高存储密度、数据传输速度和能效，可以很好地满足AI服务器、数据中心、边缘计算设备、智能终端等新型计算对高带宽、大容量、低延迟内存的需求。公司进行3D DRAM产品的研发将进一步丰富公司存储产品线，提高公司产品的综合竞争力。

3、不断扩大公司业务范围，推动公司经营业绩的不断提升

3D DRAM产品市场潜力巨大，其应用场景预计将从服务器向个人电脑、汽车电子等领域全面渗透。公司在3D DRAM领域的布局，将有助于公司及时抓住新兴市场机会，进一步扩大公司业务范围，提高公司产品的销售规模，推动公司经营业绩的持续提升

（四）项目投资内容及投资概算

“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”预计投资金额为23,560.28万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目投资内容	项目投资金额
1	仪器设备购置	4,464.75
2	软件购置	5,291.40
3	开发费用	11,504.00
4	培训及咨询费用	158.00
5	预备费	2,142.13
	合计	23,560.28

（五）项目经济效益分析

本项目符合目前的市场发展趋势，能够保障公司及时推出满足新兴市场发展需求的新型高带宽存储芯片产品与解决方案，以抓住 AI 快速发展带来的市场机遇，实现公司销售收入的不断提升。该项目属芯片研发及产业化项目，预计项目建设期第二年首款芯片产品面世，项目建设期内开始实现销售收入。项目建设期结束后，公司将通过此次项目的实施，继续推出容量更大、性能更强的 3D DRAM 芯片。

该项目的实施将有助于公司业务范围的不断扩大,与公司正在布局的 AI SoC 芯片业务形成协同效应,帮助公司实现经营业绩的持续增长。同时,该项目将推动公司创新技术的发展,帮助公司快速展开在新兴市场的技术研发,进一步加强公司在核心技术方面的积累,提高公司产品的竞争优势,符合公司长期发展利益。

（六）项目风险与对策分析

1、市场变化风险

电子行业的市场需求变化较快,产业格局和市场热点也不断发生着变化,虽然目前市场对 3D DRAM 产品需求呈现出迫切的发展需求,对其应用前景普遍乐观,但不排除在项目实施过程中出现市场环境和发展趋势发生变化的情况。公司将不断加强市场把握能力,加强对市场变化的敏感度,提高公司对市场的判断力和快速反应能力。如果市场环境发生重大变化,公司将及时进行项目调整,以避免出现项目实施的重大损失。

2、技术更新换代风险

电子产品市场发展变化较快,尤其在目前人工智能技术快速迭代的情况下,技术更新换代具有一定的不可控性。如果公司产品升级无法满足市场和技术变革的需要,将可能影响公司 3D DRAM 产品的市场竞争力和公司总体的盈利能力。公司将密切关注相关技术与市场的发展与变化,加大研发投入,根据市场需求及时进行技术的研究和发展。

3、人才风险

近年来,集成电路设计领域的快速发展加大了行业内各企业对相关人才的需求,给公司带来人才流失的可能;本次项目的实施将对公司的人才队伍提出更高的要求,使得公司存在人才资源不足的风险。公司将加强人才的培训和激励,加强企业文化的建设,吸引和引进更多的优秀人才,为项目实施提供坚实的保障。

4、市场竞争风险

随着人工智能产业的快速发展,当市场呈现巨大需求时,竞争将随之加剧。公司将依托在高品质、高密度 DRAM 产品上的深厚技术积累和质量控制体系,采用差异化策略,突出产品的高品质、高可靠性、高性价比等特点,增强产品的市场竞争力。同时,公司将加强市场拓展能力,与客户建立更为密切的关系,以在激烈的市

场竞争中保持竞争优势。

五、本次募集资金投资项目延期及变更对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

本次变更募集资金投资项目是根据市场和公司的实际情况进行的调整，是为了更好地抓住AI技术发展所带来的新的市场发展机遇，以推动公司业务规模的不断扩大和持续发展；同时，该项目将进一步加强公司在核心技术方面的积累，提高公司产品的竞争优势，强化公司的综合竞争力。本次变更符合公司长期发展利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、董事会、监事会审议情况及中介机构对募集资金投资项目延期及变更的意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于募集资金投资项目变更的议案》。董事会认为：

公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合公司的实际经营情况和市场综合环境因素，基于谨慎原则对募集资金投资项目“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”的投资进度进行调整，符合公司的实际发展的根本利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违背中国证监会、

深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

公司根据总体规划，拟将“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”，并由公司下属全资子公司芯成半导体（上海）有限公司承担。本次变更是在当前AI技术快速发展的市场环境下，结合公司实际经营情况和业务特点等因素做出的决策，符合目前的市场发展趋势，使公司能够及时推出满足新兴市场发展需求的新型高带宽存储芯片产品与解决方案，以抓住新兴市场的机会，实现公司销售收入的不断提升。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月17日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于募集资金投资项目变更的议案》。监事会认为：

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况调整“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”的实施进度，未调整项目的实施内容和投资总额，不会对项目实施产生实质性影响，符合公司发展的根本利益。本次公司募集资金投资项目延期的调整有利于切实保障项目的实施质量，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违背中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

本次变更募集资金投资项目的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是在当前AI技术快速发展的市场环境下，结合公司实际经营情况和业务特点等因素做出的决策，符合目前的市场发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司募集资金投资项目变更的事项。

（三）国泰海通证券股份有限公司的核查意见

经核查，国泰海通认为：公司本次部分募集资金投资项目延期及变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求。公司本次部分募集资金投资项目延期事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，

不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目生产经营及未来发展的需要；本次部分募集资金投资项目变更事项系基于市场环境，结合公司实际经营情况和业务特点等因素做出的决策，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金、损害公司和股东利益的情况。公司董事会和监事会已审议通过相关议案，表决程序合法合规。因此，国泰海通对公司本次部分募集资金投资项目延期及变更事项无异议。

（四）中德证券有限责任公司的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：北京君正本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形。中德证券对北京君正本次部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

（一）第六届董事会第二次会议的决议；

（二）第六届监事会第二次会议的决议；

（三）国泰海通证券股份有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司部分募集资金投资项目延期及变更的专项核查意见；

（四）中德证券有限责任公司关于北京君正集成电路股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日